

Tuotteen Kuvaus:
Pikatiedot

Lähtöisin	Guang dong, Kiina (Manner)	Tuotenimi	O-Johtavat
Pohjamateriaalia	FR-4, alumiini	Kuparin paksuus	0.5oz-5oz
Min. Reiän koko	0.2mm	Min. Viivan leveys	0.2mm
Pinnan viimeistely	upotus kulta, OSP, lyijytön HASL	Hallituksen paksuus	0.2mm
sovelletaan	led, matkapuhelin, ilmastointilaitteet, pesukoneet	merkki	Teollisuuden ohjauspiiri
todistukset	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / CTN	10PCS-100PCS
paino	0,01 kg -5 kg	MOQ	10kpl
Mallinumero	Power Bank PCB-kokoonpano pcba valmistaja	Min. Riviväli	0.2mm
väri-	sininen, punainen, vihreä, black,yellow	hinta	\$ 0,1- \$ 10
desigh tyyppi	asiakkaan vaatimus	koko	0.01m3-10m3

Pakkaus & Toimitus

Pakkaustiedot	16 vuotta ammatillinen OEM PCB hallituksen valmistaja
Toimitustiedot	7-12 päivää

Tuotteen Kuvaus

16 vuoden ammattimainen OEM-piirilevyjen valmistus

erä	2014		2015 ~ 2016		2017 ~ 2018	
	tilavuus	Näyte	tilavuus	Näyte	tilavuus	Näyte
Kerroslaskenta	32	42	38	44	42	48
Minilähetys / tila (µm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
Minin porausreikä halkaisija (mm)	0,15	0,10	0,15	0,10	0,15	0,10
Kuvasuhde PTH: stä	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Mikä tahansa kerroksen yhteenliittäminen	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Levyn täyttö	J00	-	J00	-	J00	-
Min. ydinpaksuus (ei sisällä kuparia) (µm)	50	40	40	30	40	30
Min. Laserporan halkaisija (µm)	75	65	65	50	50	40
Via haudattu reikä / pinottu kautta materiaali	J00	-	J00	-	J00	-
Sulautettu kondensaattori PCB	J00	-	J00	-	J00	-

Pintaprosessi

Lyijytön HASL, ENIG, OSP, Immersion hopea, Immersio-tina,
Flash kulta, kultainen sormisuojaus, selektiivinen kova kullattu
pinnoitus,
Peitettävä juotosmassiini, Carbon muste



